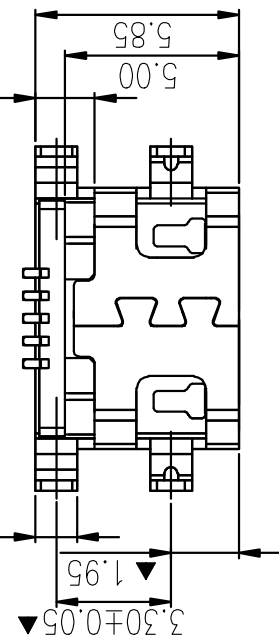
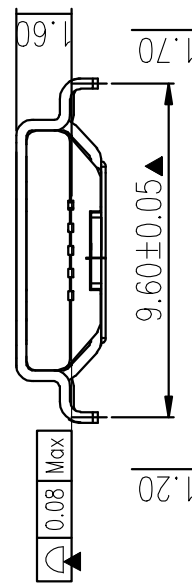
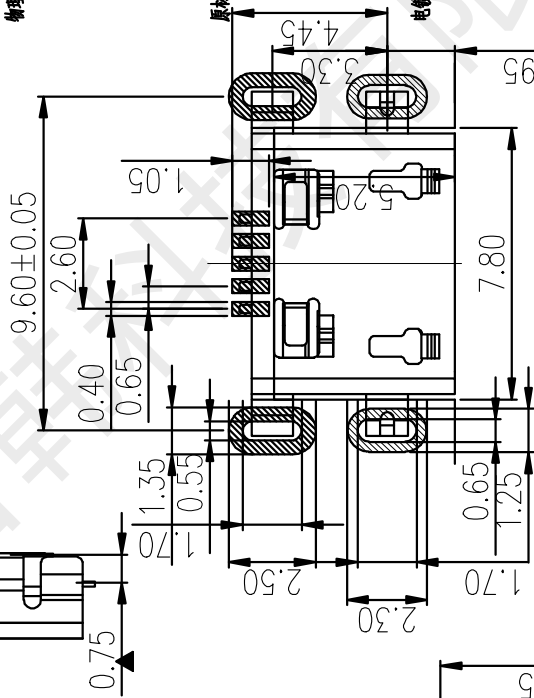
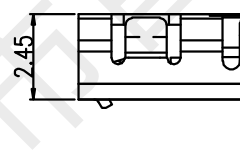
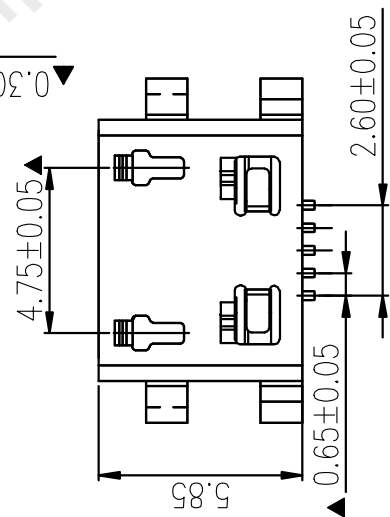
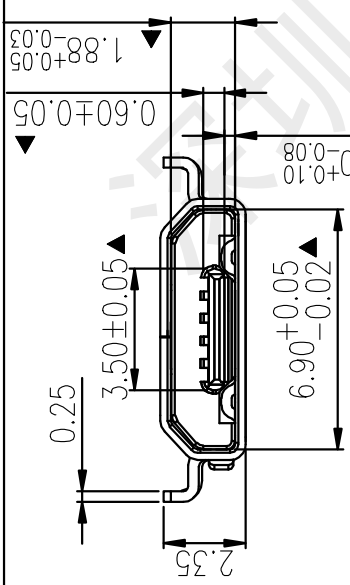
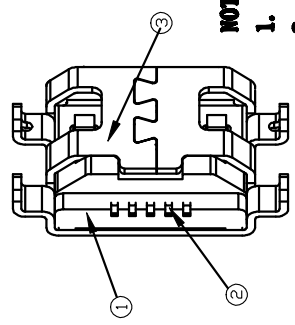


A B D E

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作



规格书 Specifications:

电气特性 Electrical:

- 1. 额定电流: Current Rating 1.8A/contact terminal
- 2. 额定电压: Voltage Rating 30V DC
- 3. 接触电阻: Contact Resistance 50 milliohms MAX
- 4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage: 300 V AC AT Sea Level
- 5. 绝缘电阻: Insulation Resistance: 100MEGA ohms MIN

物理性能 Mechanical:

- 1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force Mate force: 3.0kgf(MAX) Unmate force: 0.7kgf(MIN)
- 2. 机械寿命: 5000次

原材料 Material:

- 1. 塑胶 Housing: Hing Temperature Tnermaplastic Ul 94V-0 LCP Black
  - 2. 端子 磷铜 C5191 EH
  - 3. 外壳 Shell: H65 EH
- 电镀 Finish:
- 1. 端子 Contact: Plated Gold in Mating Area; Tin On Solder Tails
  - 2. 外壳 Shell: Nickel Plating (电镀自动上锡)

RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)  
GENERAL TOLERANCES: ±0.05

QUALITY	I	II	III
X.DXX	±0.01	±0.02	±0.03
X.IX	±0.02	±0.03	±0.04
X.X	±0.03	±0.04	±0.05
X	±0.04	±0.05	±0.06
A.B.C	±0.05	±0.06	±0.07

表面处理	材料	比例	单位	图号	日期	姓名
镀金	磷铜	1:1	mm	MI CRO 4PCB0.8 ZB	2020.8.17	李春风
镀锡	磷铜	1:1	mm	xxxxxxx	2020.8.17	钟华华
镀镍	磷铜	1:1	mm		2020.8.17	罗李金



深圳市首韩科技有限公司

SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO.,LTD

Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491

# 承 认 书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 Customer:

\_\_\_\_\_

产品名称 Project:

Micro USB

规格型号 Part No:

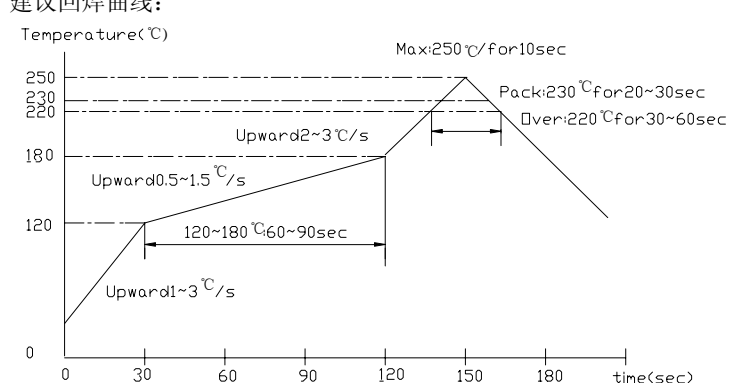
MICRO 4PCB0.8 ZB

### 贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	李春风	
审核/Check	钟华华	
批准/Approved	罗孝金	

1. 物料明细:			
1.1. 塑胶部分: LCP UL94V-0			
1.2. 接触端子部分: C5191R-H, 镍底, 接触部位镀金 1 $\mu$ ”			
1.3. 外壳部分: H65, 外壳镀镍底 50 $\mu$ ”, 镀锡 80 $\mu$			
2. 工作条件:			
2.1. 工作电流: 1.8Ampere			
2.2. 使用温度: -30 $^{\circ}$ C~+80 $^{\circ}$ C			
3. 电气性能部分			
序号	测试项目	规格和标准	测试方法及参考标准
3.1	接触阻抗	50m $\Omega$ MAX	以低功率电流测试产品接触部位阻抗值 参考: EIA 364-23A
3.2	绝缘阻抗	1000M $\Omega$ MIN 500V DC	测试相邻接触脚位之间塑胶阻抗值 参考: EIA 364-21A
3.3	耐压测试	300V AC 1分钟 0.5mA	以 0.5mA 的电流测试接触脚位之间塑胶耐高压 1 分钟 参考: EIA 364-20A
4. 机械性能部分			
4.1	插入力	3.0kgf MAX	与线端匹配时, 线端以 25mm/分速度插入时的力 参考: EIA 364-13A
4.2	拔出力	0.7kgf MIN	与线端匹配时, 线端以 25mm/分速度拔出时的力 参考: EIA 364-13A
4.3	端子单PIN保持力	0.5 kgf MIN	接触 PIN 以 25mm/分速度从塑胶中退出来的力
4.4	寿命测试	1. 产品外观无明显损伤 2. 插入力: 3.0kgf MAX 拔出力: 0.7~1.8 kgf	以每小时 600 次匀速插拔产品 5000 次 参考: EIA 364-09A
4.5	振动测试	10 <sup>-6</sup> 秒	以每分钟频率由 10HZ 至 55HZ, 再回到 10HZ 为一循环, 连续测试 X/Y/Z 三个方向各 2 小时。 振幅为 1.5mm 参考: EIA 364-28A
5. 环境性能部分			
5.1	沾锡性	吃锡面积达 95%以上	产品焊接区于温度为 235 $\pm$ 5 $^{\circ}$ C锡炉中浸泡 5 $\pm$ 0.5 秒 参考: MIL STD-202F
5.2	耐高温	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 100m $\Omega$ MAX 3. 绝缘阻抗 100M $\Omega$ MIN	将产品置于 85 $^{\circ}$ C的高温炉中 96 小时后, 再于常温中置放 3 小时后观察。 参考: MIL STD-1344A
5.3	低温性	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 100m $\Omega$ MAX 3. 绝缘阻抗 100M $\Omega$ MIN	将产品置于-40 $^{\circ}$ C的低温炉中 96 小时后, 再于常温中置放 3 小时后观察。 参考: MIL STD-1344A
5.4	耐湿性	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 100m $\Omega$ MAX 3. 绝缘阻抗 100M $\Omega$ MIN	将产品置于温度为 40 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C, 湿度为 90~95RH 环境中, 120 小时后观察。 参考: EIA 364-31A
5.5	耐腐蚀性	1. 外观无明显腐蚀 2. 接触阻抗 50m $\Omega$ MAX	将产品置放于盐水浓度为 5%, 温度 35 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C的盐雾箱中连续喷雾 12 小时, 于常温放置 1 小时后观察产品。 参考: EIA 364-26A
5.6	耐焊接性	1. 外观无明显变色、起泡; 2. 焊脚吃锡平滑	建议回焊曲线:  <p>The graph shows a reflow soldering temperature profile. The y-axis is Temperature (°C) from 0 to 250. The x-axis is time (sec) from 0 to 180. The profile starts at 0°C, rises at 1~3°C/s to 120°C, holds at 120-180°C for 60-90sec, then rises at 0.5~1.5°C/s to 180°C, then at 2~3°C/s to 230°C, holds at 230°C for 20~30sec, peaks at 250°C for 10sec, then falls at 2~3°C/s to 220°C, holds at 220°C for 30~60sec, and finally falls to 180°C.</p>